

# 超大规模集成电路老化测试系统



LSIC7000 2x16ZONE

该系统采用TDBI技术,可进行室温+10°C~150°C HTOL老化测试,老化过程中实时检测被测器件的输出信号,过程中自动对比向量。

- 实时检测被测器件的信号及电流状态,自动对比过程向量
- 选用硬公制高速连接器,大幅提高测试信号完整性
- 可根据不同器件封装、功率等要求,定制专用老化测试板
- 采用专用大电流连接器,具有高可靠性、稳定性,MTBF大于20000小时

## LSIC7000 产品特性

试验温区	2	信号输入输出电压	0.5~5V
试验温度	室温+10°C~150°C	IO驱动电流	DC≥50mA,瞬时电流≥80mA
老化试验区	16/32	DPS电源	0.5~6.0V/25A(可选配10V/10A)
数字信号频率	12.5MHz	DPS电源数	2~8(可根据客户需求配置)
向量深度	16Mbit	DPS输出保护	OVP(过压),UVP(欠压),OCP(过流)
信号通道数	184路(其中32路双向IO)	整机供电	三相AC380±38V
时钟组数	8	最大功率	35KW(典型)
信号周期	80~20480ns	整机重量	1600KG(典型)
时序边沿	双沿	整机尺寸	3200mm(W)×1674mm(D)×2366.2mm(H)
PIN格式	8种		

## 适用标准

GJB548B MIL-STD-883 MIL-STD-38510 AEC-Q101 JESD22A-108

## 适用器件

适用于通用集成电路存储器、FPGA、ARM、DSP等超大规模集成电路